

中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司

增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“优迅股份”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定履行持续督导职责，对优迅股份本次增加募集资金投资项目实施主体及实施地点事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2397 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）2,000 万股，发行价格 51.66 元/股，募集资金总额为人民币 103,320.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 92,768.83 万元。以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 12 日出具的《厦门优迅芯片股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]361Z0063 号）审验确认。

公司（含子公司）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。

二、募集资金投资项目基本情况

《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目	46,780.65	46,780.65
2	车载电芯片研发及产业化项目	16,908.47	16,908.47
3	800G 及以上光通信电芯片与硅光	17,217.38	17,217.38

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
	组件研发项目		
	合计	80,906.50	80,906.50

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，超募资金为 11,862.34 万元（以上数据如有尾数差异，为四舍五入所致）。

三、本次募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的情况

为优化资源配置、提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规章制度的规定，公司新增全资子公司武汉芯智光联科技有限公司（以下简称“武汉芯智光联”）作为“下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目”实施主体；新增公司作为“车载电芯片研发及产业化项目”实施主体；新增公司及全资子公司上海优迅芯创芯片科技有限公司（以下简称“上海优迅芯创”）作为“800G 及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目”的实施主体。公司将分别与上述子公司共同实施上述募投项目。

（一）新增募投项目实施主体的基本情况

1、武汉芯智光联作为公司的全资子公司，其基本情况如下：

公司名称	武汉芯智光联科技有限公司
统一社会信用代码	91420100MADFNAB660
法定代表人	柯腾隆
注册资本	1,000 万元
成立日期	2024 年 3 月 29 日
住所	湖北省武汉市东湖新技术开发区关山一路一号华中曙光软件园内恒隆大厦 A 栋 A301 室（自贸区武汉片区）
经营范围	集成电路设计，集成电路销售，集成电路芯片设计及服务，电子产品销售，电子元器件零售，软件开发，软件销售，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，技术进出口，货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、上海优迅芯创作为公司的全资子公司，其基本情况如下：

公司名称	上海优迅芯创芯片科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MAEHM8N9XX

法定代表人	柯腾隆
注册资本	3,000 万元
成立日期	2025 年 4 月 24 日
住所	上海市浦东新区智萃科技中心创新魔坊三期 4 号楼 501
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；电子元器件零售；软件开发；软件销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）募投项目实施主体及实施地点的调整情况

经调整后，公司募投项目的实施主体及实施地点情况如下：

项目名称	拟投入募集资金金额 (万元)	新增前		新增后	
		实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目	46,780.65	优迅股份	厦门市	优迅股份、武汉芯智光联	厦门市、武汉市
车载电芯片研发及产业化项目	16,908.47	武汉芯智光联	武汉市	优迅股份、武汉芯智光联	武汉市、厦门市
800G 及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目	17,217.38	武汉芯智光联	武汉市	优迅股份、武汉芯智光联、上海优迅芯创	武汉市、厦门市、上海市

公司及子公司可根据募投项目建设安排及资金需求，在《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》约定的拟投入募集资金范围内，一次或分次逐步向实施主体提供借款，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。

除新增募集资金投资项目实施主体及实施地点外，原募集资金投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变更。上述变更不会对公司、武汉芯智光联及上海优迅芯创的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司、武汉芯智光联及上海优迅芯创将根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所有关规则的要求规范使用募集资金。

四、增加募集资金投资项目实施主体及实施地点对公司的影响

增加募投项目实施主体是结合公司募投项目未来实施计划与公司实际经营发展的需要，旨在合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，推进募投项目的顺利实施，符合公司长期利益及募集资金使用安排。增加的实施主体为公司或公司的全资子公司，该调整未改变募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等，募集资金用途未发生变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司增加募集资金投资项目实施主体及实施地点事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的要求。该事项符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人同意公司本次增加募集资金投资项目实施主体及实施地点。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



戴五七



马 锐

